

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于对外投资项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的的基本情况

公司与苏州工业园区苏相合作区管委会于2021年12月3日签署了项目投资协议，公司拟在苏州市苏相合作区购置约50亩土地（土地具体面积以政府批复为准）用于建设新的生产基地，生产装配业务集成化产品和应用于半导体设备、新能源及电力设备、医疗设备等领域的高端装备制造。

考虑到分期建设有助于实现长期和中短期目标的平衡，在保证原总投资5亿元和总建设规模不变的情况下，公司拟将原来的项目分为两期项目建设，分为“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”和“新能源等领域高端装备精密金属部件生产新建项目”。

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、2022年5月9日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于分期建设对外投资项目的议案》，具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《关于分期建设对外投资项目的公告》（公告编号：2022-010）、2022年5月10日披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025）。

二、投资项目的进展情况

近日，公司取得了苏州市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》以及苏州工业园区行政审批局颁发的《建设用地规划许可证》。《不动产权证书》和《建设用地规划许可证》主要内容如下：

- 1、权利人/用地单位：苏州华亚智能科技股份有限公司
- 2、项目名称：SXDK20220002 地块
- 3、坐落/用地位置：苏相合作区春兴路南、华阳路东
- 4、权利性质/取得方式：出让
- 5、用地面积：土地使用权面积为33314.00m²

三、其他说明

除上述进展外，截至目前，公司拟投资的“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”和“新能源等领域高端装备精密金属部件生产新建项目”已经分别完成了备案，取得苏州工业园区行政审批局颁发的投资项目备案证。

公司承诺依法依规办理各项报建审批手续后开工建设。

四、备查文件

- 1、《不动产权证书》；
- 2、《建设用地规划许可证》；
- 3、半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目的《投资项目备案证》；
- 4、新能源等领域高端装备精密金属部件生产新建项目的《投资项目备案证》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日